

わが社の「ひとわざ(一技)」PRシート

【茅野・産業振興プラザ用】

分類No: _____

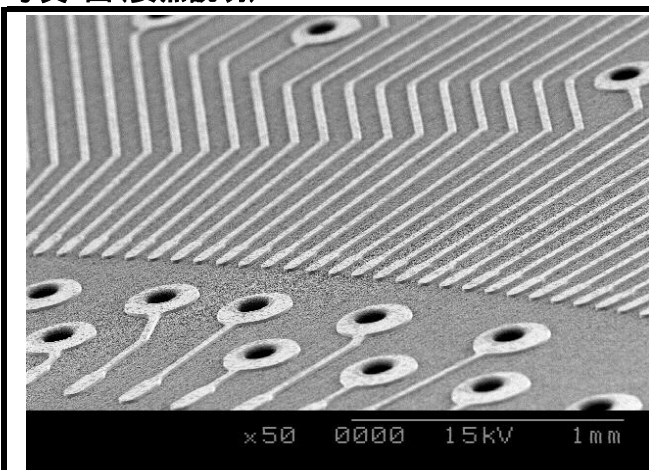
登録No: _____

ひとわざ(一技)名: 最新鋭の設備と固有技術による極薄・微細配線基板加工

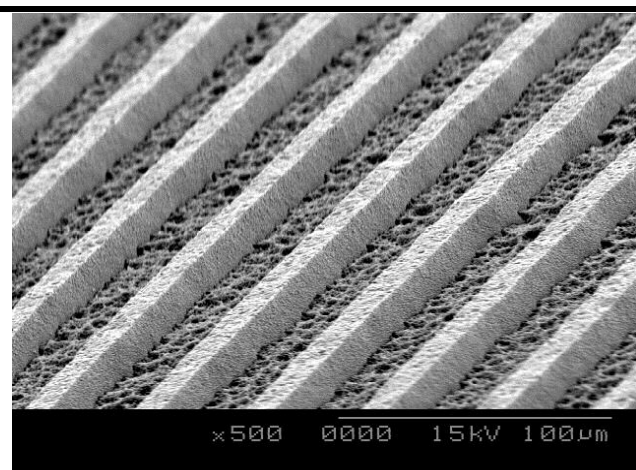
概要(200字目安)

創業依頼一貫して薄板、微細配線加工技術を核として、国内半導体トップメーカー様をはじめ、国内外の半導体実装メーカー各社様との直接取引の他、半導体パッケージ基板では、世界トップに位置する基板メーカーへのOEM供給などを通して、市場の求める技術開発を行い、現在は厚み40μ mの材料を使用した極薄基板、配線幅25μ mの微細配線量産対応技術を確立しています。

写真・図(要点説明)



半導体パッケージ基板銅配線



微細配線:配線幅/間隔幅=25/25μm

企業概況

| | | | | |
|----------|-----------------------------|-------|----------|--|
| 会社名 | 株式会社 リョウワ | | 代表者名 | 五味 健 |
| | | | 窓口担当 | 営業管理部 久保川 |
| 事業内容 | プリント基板製造・販売 | | U R L | http://www.rvowacoltd.co.jp |
| 主要製品 | ・半導体パッケージ基板 ・COB基板 | | | |
| 住所 | 〒391-0216 長野県茅野市米沢245 | | | |
| 電話/FAX | 0266-73-5470 / 0266-73-3803 | | E-mail | kubokawa@ryowacoltd.co.jp |
| 資本金(百万円) | 78.5 | 設立年月日 | 1982年 9月 | 売上(百万円) 2,400 従業員数 125人 |

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③取引実績 他

- ① ISO9001:2008認証取得済み
ISO14001:2004認証取得済み
- ② 半導体パッケージ基板製造ノウハウを活用した高品質プリント基板
- ③ 主要取引先 国内 株式会社東芝セミコンダクタ&ストレージ社
株式会社ジェイデバイス
株式会社ミットヨ
海外 ChipMOS(台湾、上海)
LINGSEN(台湾)
SEOUL SEMICONDUCTOR(韓国)